

吉安满坤科技股份有限公司

2026年5月19日投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年5月19日（星期二）16:00-17:00
地点	“价值在线”（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：洪俊城先生 独立董事：徐艳萍女士 董事会秘书、财务总监：耿久艳女士 保荐代表人：杨惠元先生 证券事务代表：莫琳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍下公司2026年一季度经营业绩情况</p> <p>答：投资者您好，2026年第一季度，公司实现营业收入为4.07亿元，同比增长19.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,812.34万元，同比减少35.71%，公司经营业绩的同比下降主要受上游原材料价格上涨、固定成本增加、公司加大研发投入以及理财规模下降、美元汇率波动等因素综合影响。感谢您的关注。</p> <p>2、请问公司在泰国投资建厂的进展如何了？</p> <p>答：投资者您好，感谢您的关注。公司基于业务发展及海外生产基地布局需要，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资新建设生产基地，总投资额为不超过7,000</p>

万美元。公司已在董事会的授权范围内顺利完成泰国公司的设立登记、国内备案登记、土地协议签署、增资、土地地契过户等事宜，且顺利收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的《投资优惠证书》（证书编号：68-0101-2-00-1-0），并正在逐步推进泰国工厂的基建筹备工作和针对此工厂建设的再融资计划，根据规划项目整体建设周期 36 个月，泰国工厂预计于 2027 年开始陆续投产。

3、管理层您好。在当前行业环境下，降本增效和数字化转型是很多企业的共识。请问公司今年在优化内部管理或推进业务数字化方面，大致的重点投入方向是什么？管理层预期这将在未来对公司的运营效率带来怎样的改善？

答：投资者您好，感谢您的关注。2026 年，公司围绕智能制造计划、产品研发计划、市场开发计划及人才发展计划四大方向协同推进，构建系统化战略布局。其中，智能制造计划形成“国内新建—老厂升级—海外拓展”梯次布局。国内募投项目智能化工厂已建成投产，通过 MES、EAP、QMS、APS、WMS 及 AGV 等系统集成，实现数据驱动与自动化生产；再融资项目在推动国内基地全面智能化改造的同时，向泰国工厂复制国内智能化工厂成功模式，构建全球化制造网络。公司将继续立足印制电路板行业，坚持以技术研发为驱动，加强产品创新，持续跟踪下游行业的发展趋势和客户应用需求，力争在汽车电子（新能源汽车、自动驾驶、安全控制系统、智能座舱等）、消费电子（智能设备终端、智能家居、智能触控、TFT 光电、笔记本电脑等）、通信电子（路由器、交换机、光模块等）、工控安防（服务器电源、数据采集系统、逆变器）、计算机/服务器（存储、显卡）等领域继续深耕和突破，依托公司过往累积的各种优势，不断优化产品和服务能力，加大对一流品牌企业的市场开拓，实现国内、国际全球核心客户的全方位覆盖；同时，随着 IPO 募投项目的建成达产和泰国投资的逐

步推进，公司产能将进一步提升，从而持续提升公司核心竞争力，快速提高公司产品的市场占有率，早日实现公司跨越式发展。

4、2025 年全球 PCB 产业产值同比增长 15.8%，中国大陆增长率 19.2%，公司全年营收增长 29.93%跑赢行业均值。

请问公司具体靠哪一方面实现了超越行业增速的增长？

答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年能实现超越行业增速的增长，主要来自多方面因素的共同推动：第一是行业发展机遇叠加客户开拓带动业务增长，从中长期来看全球电子信息产业呈现增长态势，AI 领域的巨大市场机遇带动 PCB 需求提升，公司积极把握行业机遇，持续挖掘头部客户的产品需求。第二是产能释放支撑业务扩张，公司三厂募投项目实现产能稳步爬坡，能够更好地承接新增客户的订单需求，为营收增长提供了产能基础。第三是精益生产管理有效提升运营效率，面对行业竞争加剧和原材料价格上涨的趋势，公司一方面优化产品结构，加速向中高端 PCB 领域转型升级；另一方面深化精益生产管理，通过完善业务流程、落实责任管控，提升资源利用效率。第四是核心技术研发紧跟市场增长态势，公司将技术研发作为发展核心驱动力，持续加大研发投入，提升公司核心竞争力，能够更好匹配市场高端需求，支撑业务增长。感谢您对公司的关注！

5、年报提到新能源汽车、AI 服务器、机器人等是下游重点发展方向，公司泰国项目也是瞄准 AI 服务器、机器人、高速通信等领域的客户本地化产能诉求。请问 2026 年一季度营收增长 19.38%是不是已初步反映了这些领域的订单拉动，后续能否维持这个势头？

答：尊敬的投资者您好，2026 年第一季度，公司实现营业收入为 4.07 亿元，同比增长 19.38%；公司长期深耕汽车电子、工控安防等领域，目前已在新能源车载核心 PCB 产品、

AI 服务器相关 PCB 产品领域进行了前瞻性研发布局与市场拓展，新能源汽车、智能机器人、高速通信等高景气下游需求持续回暖，相关领域订单稳步落地，已对公司一季度营收增长形成明显支撑与正向拉动作用。公司当前正在推进泰国高端印制电路板生产基地项目以及智能化与数字化升级改造项目，其中泰国项目精准对接海外 AI 算力硬件、智能驾驶、工业机器人产业链本地化配套需求，投产后将完善公司海外生产基地布局，有效缩短交付周期、适配海外客户供应链布局要求，更好地服务上述领域的海外客户需求；智能化与数字化升级改造项目将进一步提升公司在高端 PCB 产品领域的生产能力、制程精度与产品品质，持续夯实高端产品交付实力，助力公司拓展相关领域市场份额、深挖优质客户资源。未来，下游 AI 算力建设提速、新能源汽车智能化升级、工业机器人渗透率持续提升带来的行业红利充足，行业整体需求具备较强支撑。公司将持续聚焦上述新兴下游领域的发展机遇，不断优化产品结构，加大高端高附加值产品出货占比，积极推动相关领域业务放量拓客，整体经营具备延续稳健增长势头的基础，相关业务发展具体情况请您关注公司后续披露的定期报告及临时公告。感谢您对公司的关注。

6、汽车电子领域 HDI 三阶域控产品主要对接什么类型的客户？是新能源车企的智能座舱域控制器还是自动驾驶域控制器？

答：尊敬的投资者您好，公司 HDI 三阶域控产品目前主要对接国内新能源汽车智能座舱域控制器产品。谢谢。

7、目前可转债的审核进度如何？

答：尊敬的投资者您好，公司在 2025 年报及 2026 年一季报披露后与监管密切沟通，及时更新并提交了本次可转债再融资相关申报文件，目前再融资项目按计划有序推动，处于交易所正常审核过程中，公司将根据审核进展及时进行信息披露。

8、从行业看，中国 PCB 行业在全球产值占比逐年提升，但竞争也在加剧。报告中对标鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份等同行的竞争，公司是否感受到了行业产能扩张带来的价格竞争压力？公司如何在这种环境中维持毛利率的相对稳定？

答：尊敬的投资者您好，当前 PCB 行业整体资本开支持续加大，随着新增产能逐步落地投产，中低端 PCB 领域市场竞争确实有所加剧，叠加原材料价格波动，行业存在一定的价格竞争压力；公司主要通过以下举措维持毛利率相对稳定：第一，契合头部客户需求，以“消费电子稳盘+汽车电子放量+AI 算力增量”为核心，聚焦细分产品领域，规避中低端赛道的同质化价格竞争；第二，持续加大高端产品研发投入，重点推进汽车电子 HDI 板、AI 服务器电源高多层板，以及光模块、显卡、存储 PCB 等高附加值产品开发，凭借技术壁垒与高毛利产品结构对冲中低端价格竞争压力；第三，加速数字化与智能制造体系升级，通过数据分析、自动化技术减少人工干预，降低产品报废率，提升生产效率，优化成本管控，平衡技术突破与成本控制的关系；第四，通过策略化采购，实时关注原材料价格变动，通过合理的成本转嫁机制对冲原材料价格波动的影响；第五，依托国内外产能的前瞻布局，适配核心下游客户需求，依托稳定的产品品质与交付能力获得价值溢价，保障盈利能力稳定。感谢您对公司的关注。

9、2025 年公司多层板收入 9.34 亿元，双面板收入 5.33 亿元，产品结构持续向多层板倾斜，这与海外 PCB 龙头高端化方向一致。请问公司未来对 HDI、高多层等更高端产品在收入结构中的占比目标是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司将持续聚焦汽车电子、AI 服务器、工业控制、通信电子等领域，尤其是在高端产品（12 层以上高多层、HDI、高频高速板、厚铜板等）方面将加大研发与市场拓展力度，不断提高高端产品供货比例，持续推动产

品结构向高附加值领域优化升级，紧跟行业高端化发展趋势。例如公司拟通过智能化与数字化升级改造项目，提升公司吉安一厂、二厂的高多层产能占比至 60%以上；公司拟通过海外生产基地建设，项目规划设计产能均以四层、六层及以上线路板与 HDI 等高端产品为主，依托海内外产能协同布局稳步抬升高端产品收入比重。后续公司将依托客户认证突破与订单持续放量，稳步提升三阶 HDI 车载板、AI 服务器高多层板等核心高端品类营收规模，逐步确立清晰的结构占比提升节奏，中长期力争实现高端 PCB 产品在整体营收中占据主导地位，进一步拉开与同行普通板材业务的差距，全面强化整体盈利水平。具体细分品类营收占比量化目标，公司将结合行业需求变化、项目投产进度及客户拓展情况统筹规划，相关规划进展敬请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注。

10、2025 年 1-9 月产能利用率为 89.39%，但年报披露三厂 HDI 板 2025 年新增业务毛利率仅 0.77%，产能利用率仅 58.28%，刚进入爬坡阶段。目前三厂 HDI 产线产能利用率是否有得到大幅提升？预计 2026 年全年 HDI 毛利率能达到什么水平？

答：尊敬的投资者您好，公司三厂募投项目重点布局高多层线路板、高端 HDI 线路板等高技术壁垒产品，2025 年项目整体处于产能建设与市场开拓并行的爬坡周期，叠加高端产品客户认证流程较长、高端订单放量节奏偏缓，前期产线产能释放不及常规成熟产线。截至 2025 年末，三厂已顺利通过多家行业头部客户资质与产品认证，产品矩阵持续完善，全面覆盖高多层汽车电子板、高多层笔记本电脑板、高多层储能板、HDI-COB/MIP 等主流高端品类，优质订单持续导入落地，现阶段产线产能利用率较上年同期已有明显改善，产能释放节奏持续加快。公司长期深耕 HDI 领域技术研发，前期多项技术储备现已进入实质成果转化阶段，其中适配 LED 显示、智能

	<p>触控、工业控制领域的 10 层二阶 HDI 产品已实现稳定批量供货，出货规模稳步扩张；定位车载智能驾驶领域的三阶 HDI 域控板已完成头部车企配套客户验证工作，目前正有序推进小批量试样及批量导入流程。伴随高端高附加值产品出货占比不断提升，产线规模效应持续凸显，单位制造费用逐步摊薄，HDI 业务盈利修复趋势明确。关于后续 HDI 产线具体产能利用率数据以及 2026 年板块整体毛利率区间，敬请您持续关注公司后续发布的定期报告与临时公告。感谢您对公司的关注。</p> <p style="text-align: center;">本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 5 月 19 日